

生成AI・高性能サーバ導入に

1名分料金で
2人目無料

不可欠なデータセンター冷却システムの動向と課題

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/2605123>

- ◆日時：2026年05月22日（金）13:00～15:00
- ◆受講料：1名につき44,000円（税込、資料付）

会員（案内）登録していただいた場合、通常1名様申込で44,000円（税込）から
・1名で申込の場合、**38,500円（税込）**へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計44,000円（2人目無料）**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：篠原電機（株） ITソリューション事業本部 専務取締役 犀川 真一 氏

【ご専門】電子回路設計、実装設計、熱力学、熱移送要素技術開発、IT部材開発

【受講対象】

- ・データセンターにおける今後の冷却動向にご興味のある方
- ・データセンターの空冷・水冷（DLC）・液浸冷却にたずさわる2～3年の若手技術者や新人の方

【習得できる知識】

- ・AIの急速な普及にともなうデータセンターの今後の冷却トレンド、液冷方式に関する技術、性能、それぞれの課題等に対する知見が得られる。

【講演の趣旨】

AIの急速な普及に伴いデータセンターの需要は年々爆発的に増加している。特に生成AIの学習や運用に必要なGPUサーバは高熱を発生するうえ、多くのサーバを同時に稼働させることから莫大な電力を消費する。一方、データセンターでは消費電力の削減と環境負荷の低減も大きな課題となっている。

この様な状況のなか、近年データセンターでは、空冷に対し高い冷却能力をもち、温度管理や排熱利用もしやすくなる液冷が主流になりつつある。複数ある液冷方式もそれぞれに長短所があり、また特有の課題をかかえている。

本講演ではデータセンターにおける今後の冷却トレンド、特に液冷方式に関する技術、性能、それぞれの課題等について解説する。

【プログラム】

1. 動向
 - 1-1 ITインフラの動向
 - 1-2 チップの発熱動向
2. 冷却システム
 - 2-1 分類
 - 2-2 熱力学の基礎
 - 2-3 DLC冷却
 - 2-4 一相液浸システム
 - 2-5 二相沸騰液浸システム
 - 2-6 LOTUS技術
3. 液浸コンソーシアムの取り組み
4. チップとTIM問題

『AIサーバー冷却【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

 Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>